



半导体设计行业更新报告： 周期探底雪中花开 静待春 色倍还人



我们认为 23 年年中是值得关注的半导体周期底部位置，股价有望提前 1-2 个季度反应。需求端来看，尽管海外需求可能在通胀见顶后迎来衰退，但从国内需求趋势和行业库存去化的节奏来看，国内需求有望在 23 年迎来边际改善。产能端来看，22Q3 和 22Q4 全球晶圆厂产能利用率呈现下行态势。

库存端来看，22Q3 半导体产业链各环节库存水位维持上行；展望 22Q4 和 23 年，随着供需关系的改善，库存水位有望见顶并切入下行通道，历史上去库存一般持续 2-3 个季度，库存水位有望于 23Q2-23Q3 迎来见底。

汽车电动化催生 BMIC、碳化硅用量提升。汽车电动化渗透率提升趋势明确。SiC 器件能够实现更优的系统效率、更高的开关频率、更小的变换器体积，同时也将从系统层面降低整车成本。目前国内外主机厂纷纷布局 SiC 赛道，将带动从设备到模块全产业链的需求增长。BMIC 是电动汽车电池安全的核心组件，随着汽车电动化升级，BMIC 的需求亦有望大幅增长。目前 BMIC 市场被海外企业垄断，国产替代空间广阔。

智能化引领汽车下半场革命，计算+感知需求升级。车正在从根本上改变其产品形态。车内智能化感知、交互、场景应用升级，ADAS 功能升级，带动大算力 SoC 需求提升。此外 ADAS 高级驾驶辅助系统装车率正在快速增长，为了实现自动驾驶功能，单车感知系统中，摄像头的使用量正在不断增加，带动 CIS 需求持续增长。

AR/VR 拐点已至，交互体验驱动硬件方案优化。显示分辨率的上升致使需渲染的像素数成倍增加，多维度交互越来越多地依赖追踪精度和数据传输的速度提升，另外，在 XR 中更多的摄像头可以更好实现深度识别、眼动跟踪、头动跟踪等功能。画质提升+多维度交互推动高算力成为 SoC 的主要发展趋势之一，同时催生更多 CIS 使用需求。

DDR5 世代更迭引领新兴内存接口及配套芯片需求。DDR5 升级趋势明确，服务器内存模组搭配的 RCD、DB 接口芯片性能要求进一步提升，并且新增 SPD、PMIC、TS 芯片需求。PC 市场 DDR5 升级则需要新增搭配 SPD、PMIC；到 DDR5 中期，PC 端还将新增 CKD 芯片。新兴增量市场将驱动接口芯片以及相关芯片应用大幅度增长。

建议关注：1) 汽车电动、智能化相关标的：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、瑞芯微、晶晨股份、韦尔股份、斯达半导、时代电气、中颖电子、赛微微电、中瓷电子、；2) AR/VR 相关标的：瑞芯微、晶晨股份、韦尔股份；3) DDR5 相关标的：澜起科技、聚辰股份。

风险提示：宏观需求不及预期风险、行业竞争加剧风险、新能源汽车

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49255

